

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	北京汉和汉华资本、霏杉（上海）私募基金、RBC GAM、Universities Superannuation Scheme (USS)、Polar Capital、Fiera Capital、Dymon Asia Capital (Dymon)、Landseer Asset Management、TT International、OASIS、Polen Capital、Veritas Asset Management、DE Shaw、HSBC Global Asset Management、Allianz Global、FSSA Investment Manager、Lazard Asset Management 等 18 家机构及 32 位个人投资者。
时间	2026年06月29日
地点	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长：陈涛 2、董事、总裁：赵启祥 3、副总裁、董事会秘书：朱溪瑶 4、资本市场部总监：周明达 5、投资者关系经理：王慧珍 6、投资者关系专员：汤佳怡

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、投资者参观公司展厅、生产车间</p> <p>二、互动交流环节具体情况如下：</p> <p>1、公司受到上游原材料涨价压力了吗？有没有顺价？</p> <p>答：公司原材料价格波动主要体现在消费类产品上，公司消费业务相对稳定，已将原材料上涨带来的成本压力合理、有序地向下游客户传导。高端产品方面，公司前期量产产品原材料价格平稳，产品定价较为稳定，新产品定价遵循市场化定价原则，将根据具体产品料号的制造难度、市场供需、原材料价格波动情况等与客户协商定价。一方面公司将通过优化供应链管理、技术创新及精细化运营等多种措施，积极对冲成本波动影响，另一方面公司快速推进与下游客户议价工作，目前 PCB 产能相对紧张，公司亦优先保障高品质、高价值量客户的产品交付。</p> <p>价格由供需决定，从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态。高端 PCB 产能扩张周期长、设备与工艺壁垒高，新增扩产项目短期难以形成有效产能供给。现阶段下游头部客户以确保供应链稳定、保障产品品质与交付为核心诉求。</p> <p>2、公司在ASIC领域的客户布局、研发进展如何？</p> <p>答：公司持续加大市场攻坚与客户拓展力度，坚守“高端化、多元化”的布局原则，丰富客户结构，深度贴近客户需求，凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，公司参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。</p> <p>目前公司已有部分 ASIC 相关 PCB 产品进行批量生产，业务进展顺利。</p>
----------------------	--

3、公司未来AI PCB关键产品的进度如何？

答：公司目前在大客户和 ASIC 客户新产品、新技术方面的布局进展顺利，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒。

公司与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，全力配合新产品的研发及量产工作。具体产品的量产时间节点将结合技术研发进度与客户需求综合确定。

4、目前 PCB 行业都在积极扩产，产能未来还会紧缺吗？ 下游是否有充足的需求支撑？

答：随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，AI 算力、AI 服务器的需求迅速增长，对 PCB 的需求量大且要求高，为行业未来的持续增长提供了强有力的支撑，未来 AI PCB 是整个 PCB 行业最具确定性的增长细分方向。

从行业发展趋势来看，信号传输带宽将持续升级，材料等级不断提高，高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，部分工序的加工时间更长、复杂度更高，这会进一步消耗高端产能，有效产出面积（平米数）呈减少趋势。当然随之而来的是公司产品价值量、产值能力在不断提升。

从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态，下游有充足的需求消化新增产能。目前，公司的扩产节奏正在加速推进，在基建、装修、设备配置及人才储备等多方面提前进行规划准备，当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。

5、如何看待公司后续毛利率等盈利能力的变化？

答：公司未来盈利能力有望保持平稳健康发展。一方面，随着高附加值、高毛利产品占比持续提升，产品结构不断优化，将对公司盈利能力形成持续的正向贡献；另一方面，公司短期盈利能力也会受到阶段性因素影响，例如公司为支撑长期发展与产能扩张带来的人员规模快速增长、研发项目持续投入、新建产线相关费用等阶段性支出的影响。

从人员情况来看，公司员工数量从 2024 年底的 1.3 万余人增长至 2025 年底接近 1.8 万人，主要是为未来产能释放与业务扩张提前进行人才储备。从研发情况来看，公司持续加大研发投入力度，聚焦核心产品技术升级、新工艺开发及新产品产业化落地，进一步提升自主研发能力与核心技术壁垒，为公司产能扩张、产品结构优化及长期可持续发展提供坚实技术支撑。

6、公司 mSAP 车间现在的运营情况如何？良率怎么样？未来可能还有什么相关规划吗？

答：公司在惠州配置了 mSAP 车间，该产能目前用于满足 1.6T 光模块的生产需求，当前在手订单饱满，产能利用率处于良好水平。目前 mSAP 产能需求旺盛，公司与相关客户保持密切沟通，将围绕客户需求进行产能布局。

此外，公司正积极推进 CoWop 技术的研发及生产工作，该技术需同时具备高阶 HDI 和 mSAP 工艺能力，预计相关 PCB 产品价值量将有较大幅度提升。

7、公司厂房十、十一推进到什么步骤了，后续还会有十

二、十三的工厂规划吗？

答：公司厂房十、十一目前正在加快建设，今年下半年将持续推进两座工厂的装修、设备安装与调试试产工作。

结合 AI 算力产业持续发展的趋势，公司积极推动国内外的产能扩张进程。国内方面，除在建厂房外，后续将依照头部 AI 算力及交换机客户需求计划新产能；海外端持续推进泰国、越南及马来西亚的生产基地建设，满足海外客户本地化生产要求。项目建设节奏将根据下游市场需求、设备交付进度、客户订单落地情况有序推进，持续保障超高多层、高阶 HDI、mSAP 等核心产品产能供给，支撑公司长期业务增长。

8、公司订单及产能利用率情况怎么样？后续业绩如何展望？

答：当前公司在手订单饱满，惠州工厂产能利用率维持在较高水平。公司正在全力以赴推进扩产，稳步推进 2030 年千亿产值目标落地。当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。新建厂房需经历厂房建设装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增等阶段，公司与客户保持密切沟通，根据客户需求推进产能准备工作，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程，公司对后续的生产经营及效益实现充满信心。

公司严格按照法律法规等监管要求履行信息披露义务，公司的经营业绩情况请持续关注公司后续披露的定期报告。

	<p>9、公司泰国工厂二期什么时候会爬坡上量？</p> <p>答：目前泰国 A1 栋二期高端产能已顺利通过多个客户的审厂认证工作，正在生产 AI PCB 产品的验证板。海外生产基地的产能释放节奏将根据海外客户的产品认证进度、海外交付偏好及实际订单需求有序推进。</p> <p>初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程，公司对后续的生产经营及效益实现充满信心。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年06月29日</p>